

3A Avg.

20 Volts

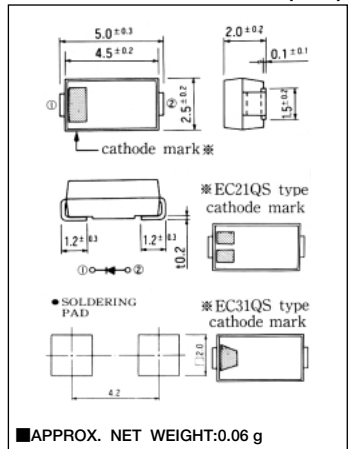
SBD

EC30LA02

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	20	V
非くり返しピーク逆電圧*1 Non-repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	25	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	$I_O$	50Hz、正弦半波通電抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave Resistive Load	$T_a=25^{\circ}C$ *2 2.1 A
			$T_l=85^{\circ}C$ Th:lead Temperature 3.0 A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_F(RMS)$	4.71	A
サージ順電流 Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50 50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し 50Hz Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	$T_{jw}$	-40~+125	$^{\circ}C$
保存温度範囲 Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-40~+125	$^{\circ}C$

■OUTLINE DRAWING(mm)



■電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	$I_{RM}$	$T_j=25^{\circ}C, V_{RM}=V_{RRM}$	—	—	3	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	$T_j=25^{\circ}C, I_{FM}=3.0A$	—	—	0.39	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient Alumina Substrate Mounted*2	—	—	108	$^{\circ}C/W$
	$R_{th(j-l)}$	接合部・リード間 Junction to Lead	—	—	23	$^{\circ}C/W$

\*1: パルス幅1μs以下, Duty 1/50以下 Pulse Width ≤ 1μs, Duty ≤ 1/50  
 \*2: アルミナ基板実装/Alumina Substrate mounted (Soldering Lands=2×2mm, Both Sides)  
 ※平均順電流定格図は、逆電力損失を含まない値です。実使用に際しましては、逆電力損失による熱暴走にご注意ください。

■定格・特性曲線

